

## CLAYTEC HFA dünn Art. 09.009

D 8 mm

- Ökologische Holzfaserausbauplatte (HFA)
- Lehmputz-Trägerlage im Holzbau
- Dünn und preisgünstig



Dünne Holzfaserausbauplatte (HFA) als Putzträger auf Holz- und Holzwerkstoffen. Die Platten können geschraubt oder geklammert werden. So entsteht auf Holz sehr einfach ein sicherer Untergrund für die Armierungslage aus Lehmklebe- und Armierungsmörtel und das nachfolgende Lehm-Finish.

Ergänzend zu diesem Produktblatt gilt der **CLAYTEC Leitfaden ökologische Trockenbauwände im System.**

## CLAYTEC HFA dünn

### Art. 09.009, D 8 mm

**Anwendungsgebiet** Holzfaserbauplatte (HFA) als Putzträger im Holzbau für CLAYTEC Lehmputze im Innenbereich. Auf Flächen der Wassereinwirkungsklasse W0-I nach DIN 18534-1, z. B. in Bädern (außer Duschbereiche) und häuslichen Küchen.

**Baustoffwerte** Druckfestigkeit  $\geq 100$  kPa, Rohdichte  $230 \text{ kg/m}^3$ , Wärmeleitfähigkeit-Wert  $0,05 \text{ W/mK}$ ,  $\mu 5$ . Wärmespeicherung:  $C_p 2,1 \text{ kJ/kgK}$ ,  $3,9 \text{ kJ/m}^2\text{K}$ . Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: E

**Maße** D = 8 mm. L = 1.200 mm, B = 600 mm. Fläche pro Platte =  $0,72 \text{ m}^2$ .

**Lieferform** 276 Platten/EW-Pal.

**Lagerung** Im Lager liegend auf Paletten, trocken. Die Lagerung ist unbegrenzt möglich. Beim Transport und Lagerung auf der Baustelle vor Nässe schützen. Auf der Baustelle liegend und eben lagern auf trockenen Paletten oder Holzern. Kanten vor Beschädigungen schützen.

**Luftfeuchtigkeit** Feuchtebeanspruchungen aus nass eingebauten Putzen und Estrichen nicht zulässig. Allgemein darf die relative Luftfeuchte bei Lagerung und nach dem Einbau 70 % nicht übersteigen.

**Materialbedarf** Bei der Ermittlung des Materialbedarfs Reserve von ca. 10% für Verschnitt etc. berücksichtigen.

**Untergrund** Der Untergrund muss tragfähig, frostfrei, trocken, sauber (Holzwerkstoffplatten staubfrei), frei von Salzbelastung, ausreichend rau und saugfähig sein. Fehlstellen grob ausbessern. Sandene Untergründe ggf. mit CLAYTEC Tiefengrund und Festiger fixieren.

**Verarbeitung** Die Platten werden mit der Stichsäge, der Kreissäge oder mit dem Cuttermesser geschnitten.

Die unterste Plattereihe wird mit etwas Abstand („Luft“) zum Boden eingebaut.

Auf Holz oder Holzwerkstoffen flächige Befestigung mit Schrauben (CLAYTEC Lehmbauplattenschrauben im Abstand von 200 mm), in der Regel aber Klammerbefestigung mit Klammern 25 mm, z. B. haubold Klammern Serie KG 700 (ETA-Zulassung), Abstand der Klammern ca. 150 mm, Randabstand 25 mm (von Mitte Klammer). Holzwerkstoffplatten sollen nicht von den Schrauben oder Klammern durchstoßen werden.

Kreuzfugen und die Fortführung von Wandöffnungsbegrenzungen durch horizontale oder vertikale Fugen sind unzulässig. Die Verarbeitung der Platten erfolgt mit um mind. 20 cm, besser 30 cm versetzten vertikalen Stößen.

**Weiterbehandlung** Für die Fugen- und Beschichtungsarbeiten darf die Raumtemperatur etwa  $+10^\circ \text{ C}$  nicht unterschreiten. Grundsätzlich ist der Feuchteintrag durch den Verputz so niedrig wie möglich zu halten. Die wandumlaufende Plattenfuge wird mit Claytec Lehm-Fugenfüller geschlossen.

Platten vor dem Mörtelauftrag sorgfältig entstauben.

Dünnlagenbeschichtung: Spalte  $\geq 1$  mm Breite mit CLAYTEC Lehmklebe- und Armierungsmörtel oder Lehm-Oberputz fein tief ausspachteln, Schraubvertiefungen und Fehlstellen schließen, trocknen lassen. Die Flächen werden 3 mm dick mit Lehmklebe- und Armierungsmörtel überzogen. Er kann auch mit der Putzmaschine angespritzt werden, Ruhezeiten sind bei dieser Anwendung nicht notwendig. In die noch nasse Oberfläche wird Glas- oder Flachsgewebe flächig eingearbeitet. Nach Trocknung YOSIMA Lehm-Designputz fachgerecht auftragen. Für das YOSIMA Lehm-Farbspachtelsystem oder das CLAYFIX Lehm-Anstrichsystem wird das Gewebe der Armierungslage nass in nass dünn überdeckt.

Dicklagenbeschichtung: Spalte  $\geq 1$  mm Breite schließen wie vor. Die Flächen werden mit der Grundierung DIE ROTE vorbehandelt. Lehm-Unterputz Stroh, Lehmputz Mineral oder SanReMo in einer Lagendicke max. 8 mm auf Wandflächen und max. 5 mm auf Decken- oder Dachschrägenflächen auftragen. In die noch nasse Oberfläche wird Glas- oder Flachsgewebe flächig eingearbeitet. Trocknen lassen. Gesamtputzaufbaudicke Wand max. 15 mm, Decken- oder Dachschrägen max. 10 mm (jeweils mind. zweilagig).

Wandflächenheizung: Spalte  $\geq 1$  mm Breite schließen wie vor. Vorbereiten der Flächen mit der Grundierung DIE ROTE oder mit Zahnpachtelung aus Lehmklebe- und Armierungsmörtel. Trocknen lassen. Vorspritz bis max. 8 mm mit einem der o.g. Lehmputzmörtel. Nach Trocknung Auffüttern bis Rohrscheitel Wandheizung. Trocknung des gesamten Unterputzes mit Heizungsunterstützung. Weiteres siehe CLAYTEC Arbeitsblatt Lehmputze.

Ergänzend zu diesem Produktblatt gilt der **CLAYTEC Leitfaden ökologische Trockenbauwände im System**.

**Verarbeitungshinweise siehe:**

